

公司代码：603986

公司简称：兆易创新

北京兆易创新科技股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兆易创新	603986	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	王中华
电话	010-82881768	010-82881768
办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层
电子信箱	investor@gigadevice.com	investor@gigadevice.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,948,543,999.27	6,173,524,466.50	77.35
归属于上市公司股东的净资产	10,100,353,393.35	5,225,477,100.07	93.29
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,330,036.70	350,625,727.54	-77.95
营业收入	1,657,803,903.71	1,202,057,595.09	37.91
归属于上市公司股东的净利润	363,221,845.12	187,486,979.70	93.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,651,243.53	159,365,023.78	95.56

加权平均净资产收益率（%）	5.85	8.22	减少2.37个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.81	0.47	72.34
稀释每股收益（元 / 股）	0.81	0.47	72.34

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				90,654		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
朱一明	境内自然人	9.56	45,010,000	0	无	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.33	39,203,728	0	无	
InfoGrid Limited	境外法人	4.90	23,063,600	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财富 28 号单一资金信托	国有法人	4.48	21,113,820	0	无	
葛卫东	境内自然人	4.48	21,095,436	14,410,036	无	
聯意（香港）有限公司	境外法人	3.34	15,710,157	15,710,157	无	
讯安投资有限公司	境外法人	2.75	12,928,348	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37	11,158,037	0	无	
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.17	10,226,155	9,785,180	无	
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.49	7,015,036	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		朱一明与香港赢富得有限公司为一致行动人。除此之外，未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，尽管受到新冠肺炎全球疫情以及中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓等因素影响，公司持续加大产品研发力度，拓宽产品应用与业务范围，不断推动技术创新与产品结构优化，

适应新基建时代下的全新技术需求，把握消费电子、工业、汽车、5G、物联网等应用领域，推进新产品量产销售，公司经营业绩保持稳定增长。2020年上半年公司实现营业收入16.58亿元，比2019年同期增长37.91%，归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，比2019年同期增长93.73%。

现将2020年上半年度公司经营情况总结报告如下：

（一）优化产品线，提升竞争力

公司的现有业务布局分为存储、MCU和传感器三大方向。

公司Flash产品，累计出货量已经超过130亿颗，持续为市场提供高性能、大容量、低功耗、小尺寸等多样化产品组合。报告期内，公司推出国内首款容量高达2Gb、高性能的GD25/GD55B/T/X系列产品，代表了SPI NOR Flash行业的最高水准，提供512Mb、1Gb和2Gb的容量选择，支持高速4通道以及兼容JEDEC xSPI和Xccela规格的高速8通道，分别采用3.3V和1.8V供电，具有多达18个主要型号的组合，并支持多种封装形式。该系列产品主要面向需要大容量存储、高可靠性与超高速数据吞吐量的工业、车载、AI以及5G等相关应用领域。公司的GD25 SPI NOR Flash产品系列，全面满足车规级AEC-Q100认证，支持2Mb至2Gb多种容量，为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供高性能和高可靠性的闪存解决方案。NAND Flash产品上，具备业界领先性能和可靠性的38nm SLC Nand制程产品稳定量产，24nm制程产品持续推进，公司将完善中小容量NAND Flash产品系列。

MCU产品，累计出货数量已超过4亿颗，客户数量超过2万家。报告期内，公司成功量产发布两个系列新产品，拓展MCU在物联网和智能化产业的广泛应用，满足工业应用级别的高精度、高可靠性需求：（1）公司发布基于Arm® Cortex®-M23内核MCU的最新产品，GD32E232系列超值型微控制器。集成了片上存储器、定时器、数据转换器和众多接口外设，并提供了全新的可编程模块（CLU），提供更强的硬件灵活性、信号处理实时性，并提供更紧凑封装，新增的高集成度精密特性对于诸如光收发器、光模块、接入网等工控系统应用非常有利。（2）公司发布基于Arm® Cortex®-M33高精度实时工业控制E507/E503系列MCU，主频高达180MHz，除了集成针对工业场景Ethernet、CAN等通用外设，该系列还加强了算力及实时处理性能，片上集成三角函数加速模块，高精度皮秒级时钟，支持1.8V~3.6V宽电压单端/全差分ADC，并提供更丰富低功耗模式以满足客户不同操作场景。此外，公司继续推进通用RISC-V MCU GD32V产品系列开发，为客户提供完整的软件包、开发套件、解决方案等支持，在报告期内GD32V也已与主流IDE工具厂商IAR、Segger达成合作，丰富了GD32V产品生态。

传感器业务来看，公司在光学指纹传感器方面，积极优化透镜式光学指纹产品、超小封装透镜式光学指纹产品、超薄光学指纹产品、大面积TFT光学指纹产品，是国内全行业最早拥有指纹全类别产品的公司。在MEMS超声指纹传感器研发方面，将基于已研发成功的超声换能器结构及工艺平台，搭配边缘端的信号处理系统，进一步拓展其在人机交互、体征监测及汽车电子等方向的应用。

（二）持续加大研发投入

集成电路行业是技术密集型行业，不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动能。公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，保证公司产品的技术先进性。报告期内，公司研发费用达到2.21亿元，相比2019年同期增长57.95%。公司在推出具备技术、成本优势的全系列产品的同时，积累了大量的知识产权专利。截止2020年6月30日，公司已获得638项授权专利，其中包含595项中国专利、26项美国专利、9项欧洲国家专利。2020年上半年共申请了28项国内外专利，新获得49项专利授权。此外，公司还拥有73件商标、18

件集成电路布图，20 件软件著作权。持续的研发投入，是公司提升技术水平和产品竞争力的有力保障。

（三）积极布局 DRAM 领域

存储芯片领域中 DRAM 等通用型产品市场规模较大，具有举足轻重的地位。公司积极整合产业资源，布局 DRAM 产品领域，进一步拓展并丰富公司产品线，提升公司的核心竞争力和行业影响力。

2019 年 9 月，公司发布非公开发行股票预案，拟募集资金用于 DRAM 芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。项目开发目标为研发 1Xnm 级（19nm、17nm）工艺制程下的 DRAM 技术，设计和开发 DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4 系列 DRAM 芯片。此研发项目的成功实施，将实现国内存储芯片设计企业在 DRAM 领域的突破，也有助于公司战略拓展业务领域。2020 年 4 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号）。2020 年 6 月 3 日，公司顺利完成本次非公开发行股票，共募集资金 43.24 亿元。目前，公司自主研发 DRAM 项目正在有序推进。

公司持续推进合肥 12 英寸晶圆存储器研发项目合作。公司 2019 年与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司签署《可转股债权投资协议》，约定以可转股债权方式对项目投资 3 亿元，并继续研究商讨后续合作方案。业务方面，公司与合肥长鑫发挥优势互补，于 2020 年 4 月签署了《框架采购协议》、《代工服务协议》及《产品联合开发平台合作协议》日常交易框架协议，推动双方在 DRAM 产品销售、代工及工程端的紧密合作。目前，公司已基本建立代销 DRAM 的销售、运营体系，客户数量与业绩逐步增长。

（四）产业上下游合作及供应链管理情况

2020 年受新冠疫情的影响，全球供应链扰动明显，国际物流运能下降且周期变长。随着国内疫情快速有效的控制，复工复产节奏加快，公司有效的配合供应链厂商将部分生产原物料切换到国内厂商，保证了生产环节有序进行。仓储物流承受住了疫情管控所带来的压力，能够及时有效的将货物发送到客户手中，2020 上半年出货量同 2019 年同期相比有一定幅度的增长。

公司进一步增进加深与主要晶圆厂如中芯国际、台积电、联华电子、华虹集团的合作，在存储器、控制器、传感器等各产品线深入合作研发。同时，公司继续秉承供应链全球化的宗旨，开拓包括中国大陆、中国台湾、日本、韩国、东南亚等地区的厂商资源，优化供应链结构，提升公司产品品质与国际知名度。公司将继续引进功能更全面的更先进的生产运营 IT 管理系统，进一步提升自动化管理能力与大数据汇总分析能力，为科学制定供应链策略提供数据支撑。

（五）准确把握市场发展，持续拓展客户

凭借多年深耕细分市场的累积和产品优势特点，公司准确把握市场发展，聚焦投入，深化各销售片区的市场开发，为客户提供全面产品线和优质服务，提升市场占有率。报告期内，公司在维持原有消费类产品市场优势的同时，积极开拓医疗、工业自动化、仪器仪表市场，取得显著成果。同时，公司积极开拓新基建相应市场，力争取得更大市场占有率。

（六）加强人才队伍建设

公司始终高度重视人才发展与培养。借助人才盘点项目的实施，有效识别关键、核心人才；持续通过线上知识传授和现场情景演练，有的放矢开展各层级各专业序列员工能力培养计划，助力各梯队人才发展。在人才引进方面，积极拓展人才储备尤其是研发人员的储备，完善招聘渠道，持续引进国内外优秀人才，以满足业务快速增长的人才需求。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒适用 ☐不适用

详情请见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日